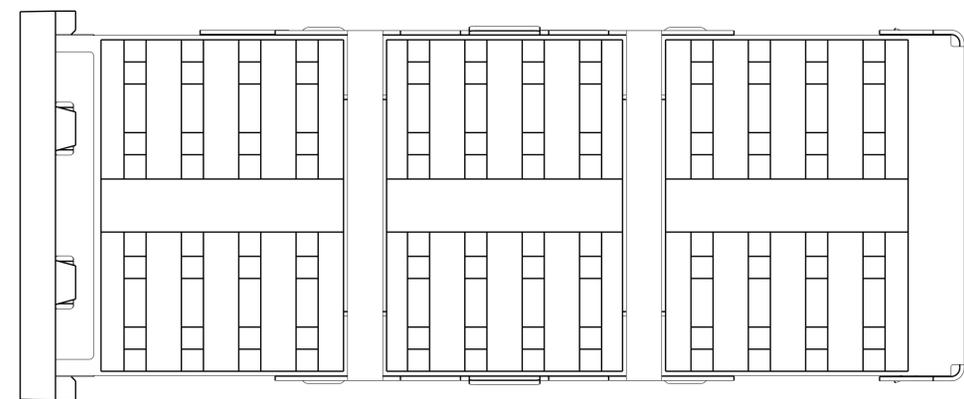
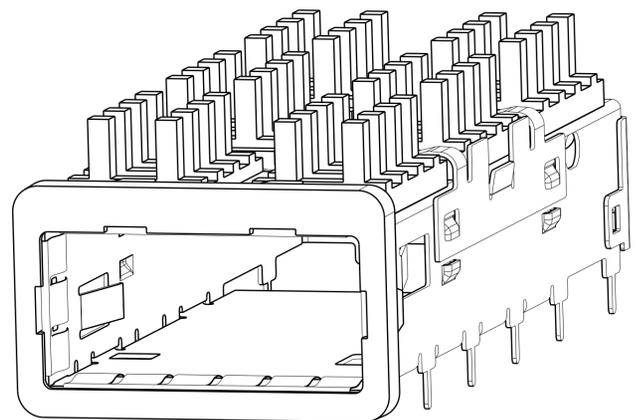
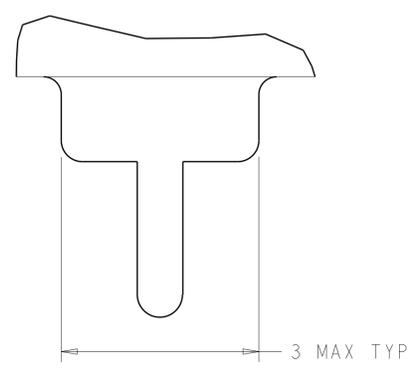
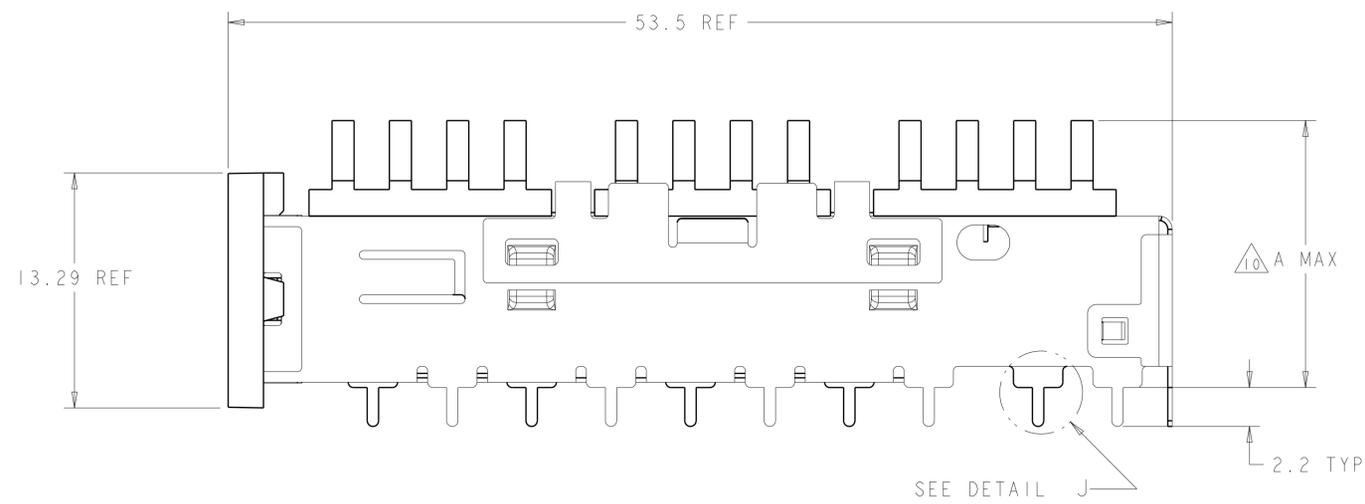
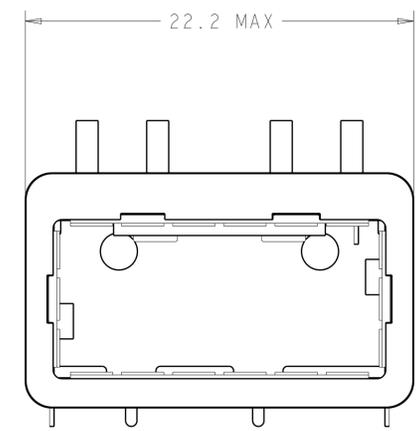


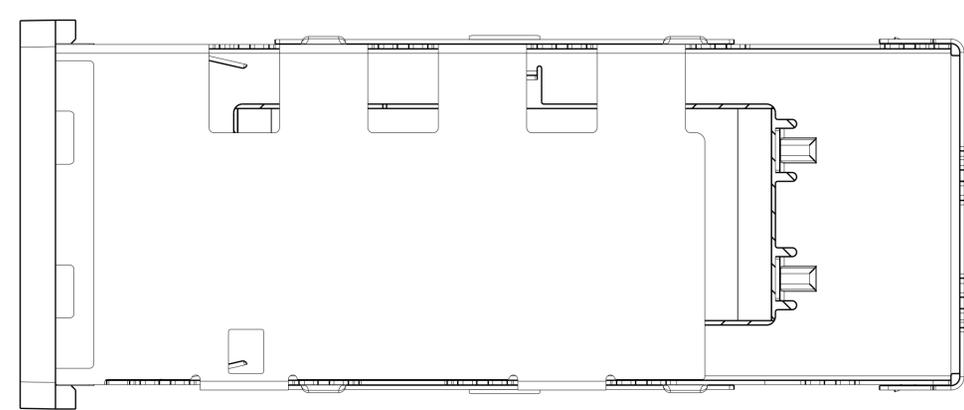
LOC		DIST		REVISONS			
GP	00	P	LTN	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		I		PRELIMINARY	23AUG2012	DZ	JY



- ⚠ CAGE MATERIAL: NICKEL SILVER, 0.25 THICK
 HEAT SINK MATERIAL: ALUMINUM
 HEAT SINK CLIP MATERIAL: STAINLESS STEEL
 EMI SPRING MATERIAL: COPPER ALLOY
 FRONT FLANGE MATERIAL: ZINC ALLOY
- ⚠ MINIMUM PITCH DIMENSION.
- 3. MATES WITH QSFP MSA COMPATIBLE TRANSCEIVER.
- ⚠ REFERENCE APPLICATION SPEC 114-13218 FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- ⚠ DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- ⚠ DIMENSION C IS THE NOMINAL THICKNESS OF CUSTOMER SUPPLIED PC BOARD, SINGLE SIDED PC BOARD MINIMUM THICKNESS: 1.45
- ⚠ HEAT SINK AND CLIP SHIPPED ASSEMBLED TO CAGE ASSEMBLY. CAGE ASSEMBLY MAY BE PRESSED INTO THE PCB AS SHIPPED.
- ⚠ DATUM -A- IS TOP SURFACE OF HOST BOARD.
- ⚠ SURFACE TRACES PERMITTED WITHIN THIS AREA EXCEPT WHERE CAGE STANDOFFS, SHOWN IN DETAIL J, CONTACT PC BOARD.
- ⚠ DIMENSION APPLIES WITH MODULE INSTALLED IN THE CAGE.
- ⚠ DATE CODE (YYWW) MARKED ON TOP OF CAGE AND CONCEALED BY HEAT SINK APPLIES TO CAGE ASSEMBLY ONLY.
- ⚠ EMI SPRING FINISH: 2µm MIN TIN.
 FRONT FLANGE FINISH: 3µm MIN TIN OVER 1.27µm MIN NICKEL OVER 5.08µm MIN COPPER.
 HEAT SINK FINISH: 0.076µm MIN NICKEL.
- 13. PRODUCT HAS NOT COMPLETED QUALIFICATION TESTING.



DETAIL J
 SCALE 20:1

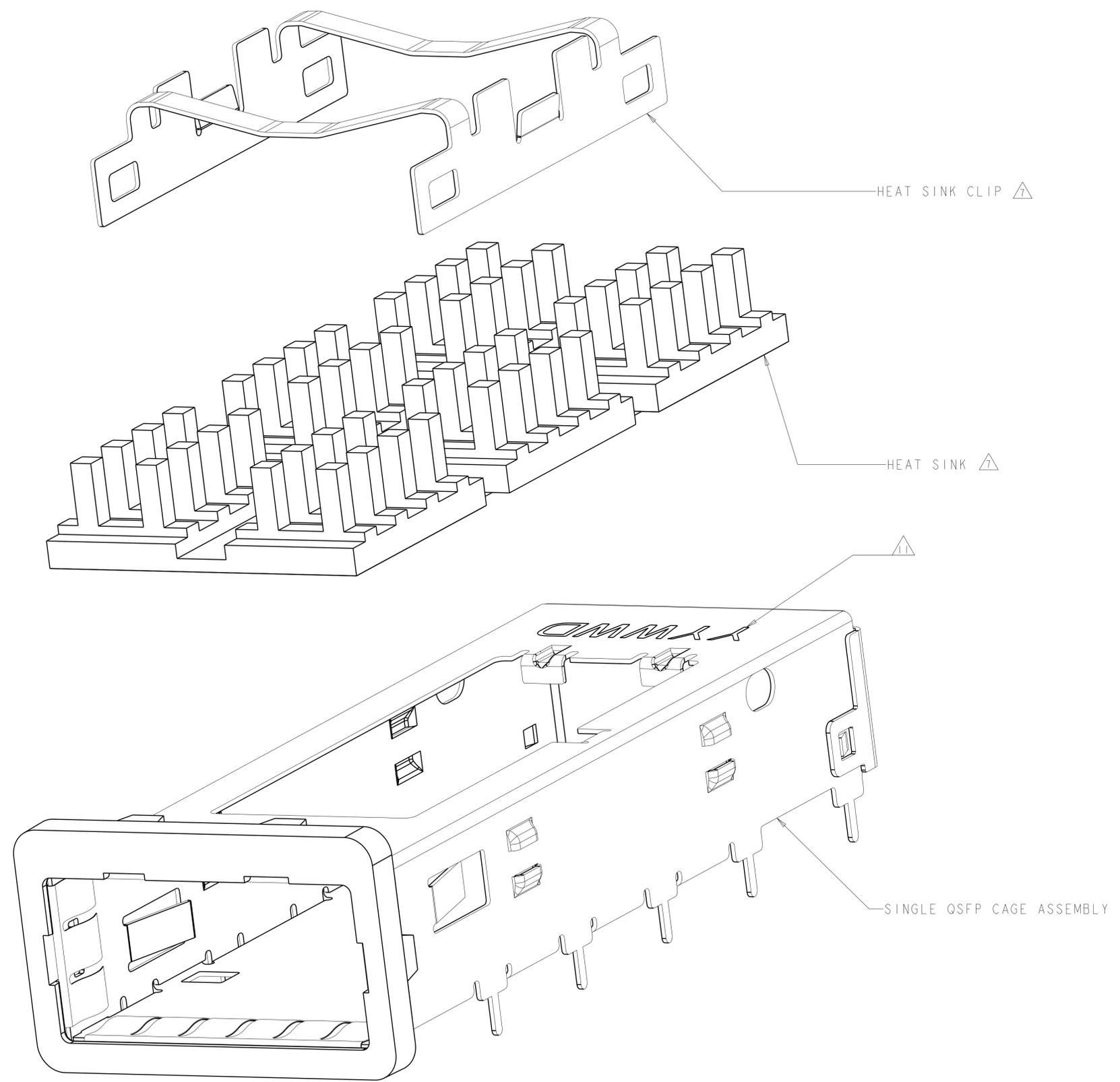


13.7	PCI HEAT SINK	2170395-1
A	DESCRIPTION	PART NUMBER

DESIGN APPROVED THIS PRINT IS
PRELIMINARY
 TO FIRST PIECE APPROVAL
 CONTACT PRODUCT ENGINEERING
 BEFORE USING THIS PRINT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: D ZHU 23AUG2012	REV: J LANG 23AUG2012	APVD: A MAI 23AUG2012	NAME: CAGE ASSEMBLY, BEZEL, QSFP WITH HEAT SINK
DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	PRODUCT SPEC	APPLICATION SPEC	SIZE	CAGE CODE
mm	0 PLC ±0.5 1 PLC ±0.5 2 PLC ±0.13 3 PLC ±0.013 4 PLC ±0.001 ANGLES ±0.001	108-2286	114-13218	A1	00779
MATERIAL:	FINISH:	WEIGHT	SCALE	SHEET	OF
			2:1	1	4
Customer Drawing		SCALE 2:1		SHEET 1 OF 4	

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTN	DESCRIPTION	DATE	DMN	APVD
GP	00	SEE SHEET 1	-	-	-

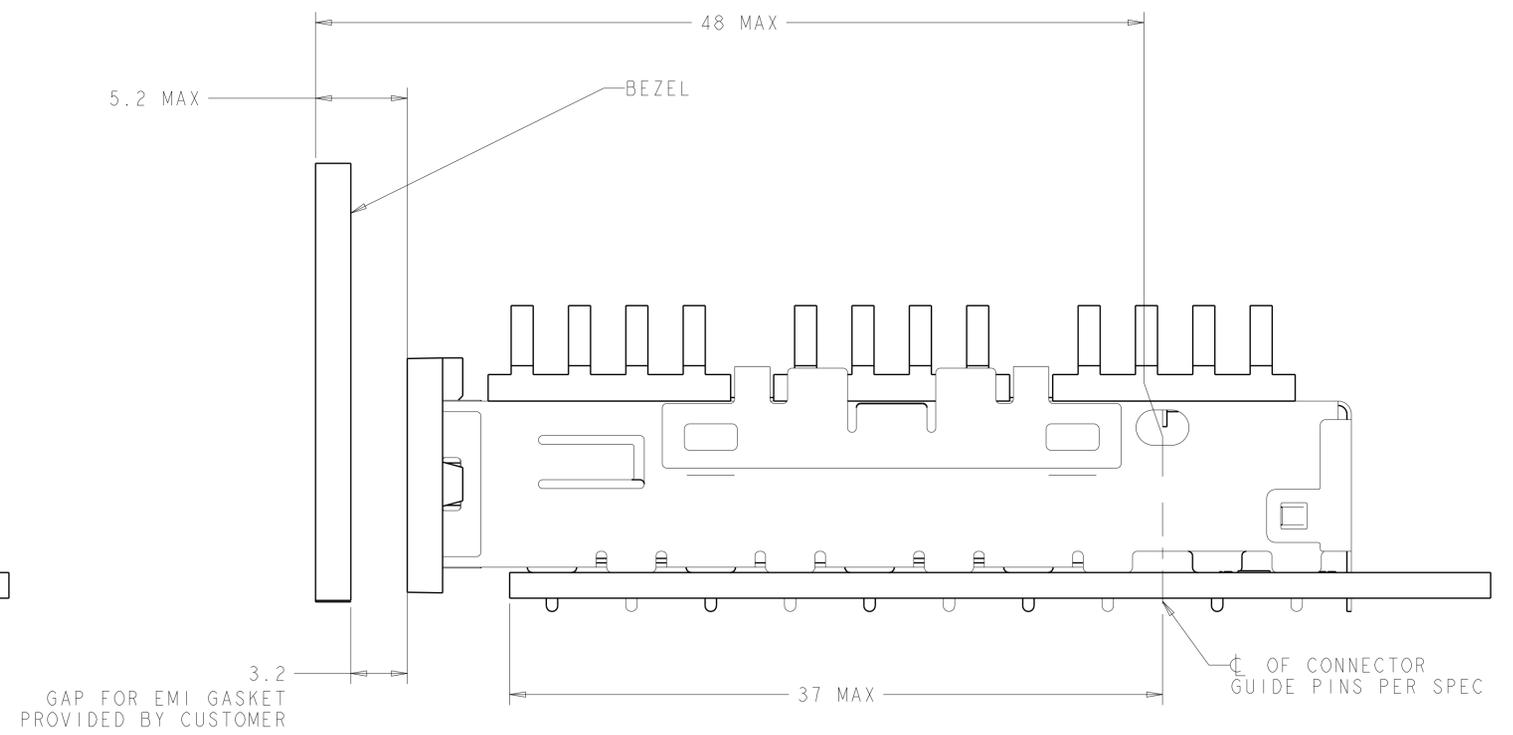
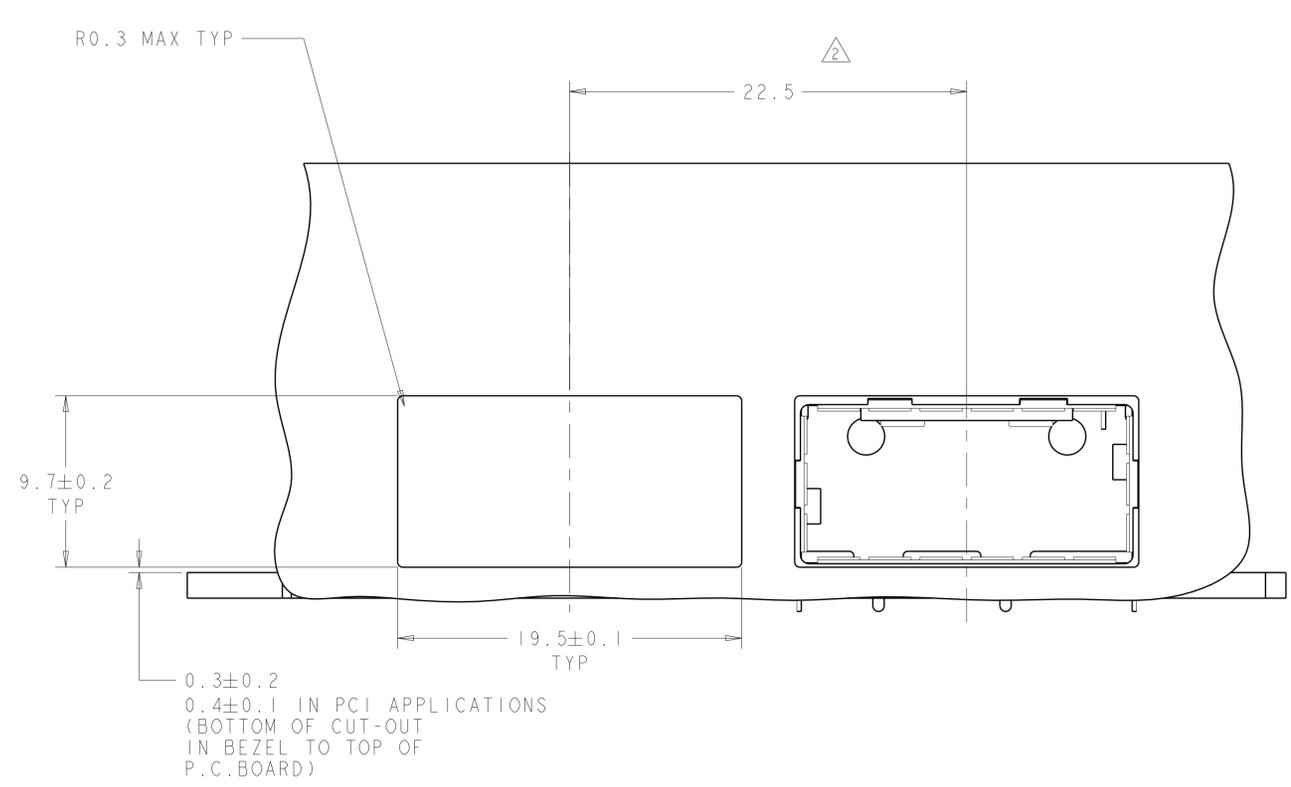


EXPLODED VIEW
 SCALE 8:1

DESIGN APPROVED THIS PRINT IS
PRELIMINARY
 TO FIRST PIECE APPROVAL
 CONTACT PRODUCT ENGINEERING
 BEFORE USING THIS PRINT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DMN D. ZHU	23AUG2012	TE Connectivity
DIMENSIONS:		CHK J. YANG	23AUG2012	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD A. CAI	23AUG2012	
mm				
				NAME CAGE ASSEMBLY, BEHIND BEZEL, QSPF WITH HEAT SINK
0 PLC ±0.5		PRODUCT SPEC		SIZE A1
2 PLC ±0.13		108-2286		CAGE CODE 00779
3 PLC ±0.013		APPLICATION SPEC		DRAWING NO 2170395
4 PLC ±0.001		114-13218		RESTRICTED TO
ANGLES ±0.0001		WEIGHT		
FINISH		Customer Drawing		
MATERIAL		SCALE 2:1		SHEET 2 OF 4
				REV 1

LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P.	LTN	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



DESIGN APPROVED THIS PRINT IS
PRELIMINARY
 TO FIRST PIECE APPROVAL
 CONTACT PRODUCT ENGINEERING
 BEFORE USING THIS PRINT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D. ZHU	23AUG2012	STE TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK J. YANG	23AUG2012	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD A. CAI	23AUG2012	NAME CAGE ASSEMBLY, BEHIND BEZEL, QSFP, WITH HEAT SINK
0 PLC	±	PRODUCT SPEC		SIZE A1
1 PLC	±0.5	108-2286		CAGE CODE 100779
2 PLC	±0.13	APPLICATION SPEC		DRAWING NO C=2170395
3 PLC	±0.013	114-13218		RESTRICTED TO
4 PLC	±0.0001	WEIGHT		-
ANGLES	±	Customer Drawing		SCALE 2:1
MATERIAL				SHEET 3 OF 4
FINISH				REV 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9